

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2026-09

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2026年3月13日

二、董事会会议决议情况 经与会董事认真审议并逐项表决,形成了以下决议: (一)审议通过关于公司组织机构调整的议案

三、备查文件 1.第八届董事会第十六次会议决议 2.《和解协议书》

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 二〇二六年三月十四日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2026-10

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月13日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 二〇二六年三月十四日

附件: 2026年安徽德豪润达电气股份有限公司组织架构图



证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2026-11

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于子公司诉讼仲裁事项进展暨 达成和解的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、诉讼仲裁事项的基本情况 安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司大连德豪光电科技有限公司(以下

二、诉讼仲裁事项的进展 截至本公告披露日,大连德豪、芜湖德豪与深圳安莹、安莹电子及其实际控制人王泽显,就前期LED业

的公告。 案件三:因LED芯片销售渠道转移纠纷,深圳安莹在香港申请仲裁,香港国际仲裁中心担任

二、和解事项董事会审议情况 公司于2026年3月13日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过《关于公司及子公司签订<

三、和解协议对外的基本情况 四、诉讼仲裁事项进展情况

五、和解协议主要内容 各方达成一致并达成和解,经协商一致并达成和解,协议内容具体如下:

六、备查文件 1.第八届董事会第十六次会议决议 2.《和解协议书》 特此公告。

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2026-12

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于子公司诉讼仲裁事项进展暨 达成和解的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2026年3月13日

二、董事会会议决议情况 经与会董事认真审议并逐项表决,形成了以下决议: (一)审议通过关于公司组织机构调整的议案

三、备查文件 1.第八届董事会第十六次会议决议 2.《和解协议书》

特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 二〇二六年三月十四日

公司代码:688630 公司名称:芯碁微装

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

2.重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已按报告中详细披露

3.公司治理及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

4.会计师事务所(会计师事务所)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会审议通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

6.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

7.本报告期主要业务简介

8.主要业务、主要产品或服务情况

9.公司投融资情况

10.主要客户、主要供应商情况

11.核心竞争力分析

12.未来展望

13.其他重要事项

14.其他重要事项

15.其他重要事项

16.其他重要事项

17.其他重要事项

18.其他重要事项

19.其他重要事项

20.其他重要事项

21.其他重要事项

22.其他重要事项

23.其他重要事项

24.其他重要事项

25.其他重要事项

26.其他重要事项

27.其他重要事项

28.其他重要事项

29.其他重要事项

30.其他重要事项

31.其他重要事项

32.其他重要事项

33.其他重要事项

34.其他重要事项

35.其他重要事项

36.其他重要事项

37.其他重要事项

38.其他重要事项

39.其他重要事项

40.其他重要事项

41.其他重要事项

42.其他重要事项

43.其他重要事项

44.其他重要事项

45.其他重要事项

46.其他重要事项

47.其他重要事项

48.其他重要事项

49.其他重要事项

50.其他重要事项

51.其他重要事项

52.其他重要事项

53.其他重要事项

54.其他重要事项

55.其他重要事项

56.其他重要事项

57.其他重要事项

58.其他重要事项

59.其他重要事项

60.其他重要事项

61.其他重要事项

62.其他重要事项

63.其他重要事项

64.其他重要事项

65.其他重要事项

2.2 主要经营模式 1.经营模式

2.研发模式 3.采购模式

4.生产模式 5.销售模式

6.售后服务 7.质量控制

8.供应链管理 9.客户管理

10.人才培养 11.信息化建设

12.可持续发展 13.社会责任

14.企业文化 15.品牌管理

16.风险管理 17.合规管理

18.知识产权保护 19.数据安全

20.环境友好 21.节能减排

22.社区建设 23.公益慈善

24.员工福利 25.职业发展

26.企业文化 27.品牌管理

28.风险管理 29.合规管理

30.知识产权保护 31.数据安全

32.环境友好 33.节能减排

34.社区建设 35.公益慈善

36.员工福利 37.职业发展

38.企业文化 39.品牌管理

40.风险管理 41.合规管理

42.知识产权保护 43.数据安全

44.环境友好 45.节能减排

46.社区建设 47.公益慈善

48.员工福利 49.职业发展

50.企业文化 51.品牌管理

52.风险管理 53.合规管理

54.知识产权保护 55.数据安全

56.环境友好 57.节能减排

58.社区建设 59.公益慈善

60.员工福利 61.职业发展

62.企业文化 63.品牌管理

64.风险管理 65.合规管理

66.知识产权保护 67.数据安全

68.环境友好 69.节能减排

70.社区建设 71.公益慈善

72.员工福利 73.职业发展

74.企业文化 75.品牌管理

76.风险管理 77.合规管理

78.知识产权保护 79.数据安全

80.环境友好 81.节能减排

82.社区建设 83.公益慈善

84.员工福利 85.职业发展

86.企业文化 87.品牌管理

88.风险管理 89.合规管理

90.知识产权保护 91.数据安全

92.环境友好 93.节能减排

94.社区建设 95.公益慈善

96.员工福利 97.职业发展

98.企业文化 99.品牌管理

100.风险管理 101.合规管理

102.知识产权保护 103.数据安全

104.环境友好 105.节能减排

106.社区建设 107.公益慈善

108.员工福利 109.职业发展

110.企业文化 111.品牌管理

112.风险管理 113.合规管理

114.知识产权保护 115.数据安全

116.环境友好 117.节能减排

118.社区建设 119.公益慈善

120.员工福利 121.职业发展

122.企业文化 123.品牌管理

124.风险管理 125.合规管理

126.知识产权保护 127.数据安全

128.环境友好 129.节能减排

130.社区建设 131.公益慈善

132.员工福利 133.职业发展

134.企业文化 135.品牌管理

数据来源:Prismark

AI需求推动PCB技术路线变革与专用设备迭代升级

随着AI服务器与高性能数据中心对算力需求的快速增长,PCB产业正加速向高多层数(20层以

上)板,高多层数(HDI AI-layer)及类载板(MLP)形态演进。相较于消费电子等其他应用领域的

LDI设备,AI算力场景的LDI设备存在显著的技术壁垒与需求差异,如AI服务器主板层数多、材料

复杂,在多次压合工艺中产生剧烈的热应力与形变,需要配备有极高精度的层间对位能力。普

通设备仅能进行简单补偿,而高端的LDI设备搭载了专有的高阶非线性形变补偿算法与分区

动态补偿技术,能够实时补偿板形的形变,确保在数十微米级精度(±5μm以内)的层

间对位精度。此外,AI服务器PCB还要求具备优异的散热性能,在高频大功率运行条件下,针

对AI芯片板级散热技术(铜覆层厚度<100μm),高端设备采用了多层铜箔与铜箔与铜箔系

统,有效改善了高功率密度下的低阻抗散热,确保了在高功率运行下的散热性能与能效。突

破了普通设备的光学对准限制,最后,AI服务器的LDI设备需要在完成大批量数据吞吐的同时

保持极高的生产效率,AI多层板的数量与板数增加,单张板量可达百GB,需要设备具备高

效的板间切换与高速扫描能力,确保设备在高速运行下的稳定性与精度。

3.2 行业竞争格局

根据国际半导体产业协会SEMI的数据,2025年全球半导体制造设备销售总额预计达到1,330亿

美元,同比增长13.7%,创历史新高。且2026年和2027年有望继续攀升至1,450亿美元和1,560亿

美元;半导体设备市场的强劲增长主要由人工智能相关投资驱动。产品范围,晶圆厂设备(含晶圆加

工、晶圆厂设施和维护)增长最快,2025年市场规模将达到1,157亿美元;测试设备和封装设备销售

增长更为强劲,2025年测试设备市场规模将达到48.19亿美元,达到112亿美元,封装设备市场

同比增长10.6%至102.4亿美元。封装设备增长的主要驱动力是先进封装,异质封装加速渗透。

图:全球半导体设备市场格局

来源:SEMI

先进封装技术受到物理极限,先进封装以相对轻松实现芯片的高密度集成,体积的微型化

和更低的成本。先进封装在提高芯片集成度、缩短芯片长度、提升芯片间电气连接速度以及性能化

的过程中扮演了重要角色。正成为助力系统级性能提升的关键因素,并满足“轻、薄、短、小”系

统集成需求。在人工智能、高性能计算、5G和自动驾驶的推动下,先进封装市场规模保持较快

增长,YOLE预计2030年先进封装市场规模将达到800亿美元,2024-2030年平均增长率为10.7%,其中

2.5D/3D封装成为AI芯片需求的首选解决方案,随着2.5D/3D集成技术不断成熟,硅中介层需求

显著扩大,重量级(RDL)封装集成至5μm,封装性能可进一步提升,YOLE预计2025年2.5D/3D

封装市场规模将达到209.5亿美元,平均增速达37%。

先进封装技术包括晶圆级封装、扇出封装及2.5D/3D封装,在先进封装技术中地位日益重要。其

广泛应用于高密度互连、晶圆级封装(WLP)以及复杂封装结构的微细加工,助力实现高密度微

加工需求。公司自主研发的扇出封装(WLP)以及复杂封装结构的微细加工,助力实现高密度微

来源:Prismark

3.公司主要会计政策、会计估计和财务报表

3.1 近3年的主要会计政策和会计估计

单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2025, 2024, 2023, 2022

3.2 报告期主要会计政策、会计估计和财务报表

单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4

3.3 报告期主要会计政策、会计估计和财务报表

单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4

3.4 报告期主要会计政策、会计估计和财务报表

单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4

3.5 报告期主要会计政策、会计估计和财务报表

单位:元,币种:人民币